

平成14年度事業報告書

自:平成14年4月1日 至:平成15年3月31日

1. 国際会議・学術講演大会・展示会等の開催(定款第4条第1号関係)

(1)国際会議「2002 ICEP」の開催

IEEE CPMT Japan Chapter と共催で第6回目の国際会議を4月17日～19日の3日間、第一ホテル東京シーフォートにおいて開催。

「アジア発の新しい実装技術の波」をテーマに海外36件を含む94件の論文発表(一般発表87, セッション招待7)。国際交流会開催。優秀論文賞5件と若い層への賞2件を表彰。

論文集(A4判・515頁)。参加者数351名(内、海外57名)。

(2)2002 マイクロエレクトロニクスショー(2002 ME Show)の開催

4月17日～19日、「最先端実装技術・パッケージング展」と称して、東京流通センターにおいて開催。

出展社数59社, 81小間, 製品技術セミナー参加社数30社・聴講者数2,823名, 新たに「実装研究セミナー」を企画・参加者数525名, 展示会来場者数13,126名。

(3)第17回エレクトロニクス実装学術講演大会の開催

3月12日～14日の3日間、東京都千代田区の東京電機大学神田キャンパスにおいて開催。特別講演1件, 依頼講演16件・一般講演142件で計159件の講演発表が行われた。

論文集(A4判・316頁)。参加登録者数957名。

(4)先端技術セミナーの開催

第30回定例セミナー

「ここまで来た!システム・イン・パッケージの最新技術動向」をテーマに8月28日, 東京・国立オリンピック記念青少年総合センターで開催。

講演件数6件。参加者数112名。

第31回定例セミナー

「将来のIT社会を担う光実装技術の最新動向」をテーマに11月15日, 東京・国立オリンピック記念青少年総合センターで開催。

講演件数6件。参加者数71名。

第32回定例セミナー

「部品内蔵サブストレート技術の最新動向」をテーマに1月31日, 東京・国立オリンピック記念青少年総合センターで開催。

講演件数6件。参加者数130名。

(5)第12回マイクロエレクトロニクスシンポジウム(MES2002)の開催

10月8日～9日, 大阪府吹田市・大阪大学コンベンションセンターにおいて開催。112件の論文発表(一般発表110, 招待講演2)が行われた。

論文集(A4判, 462頁)発行。参加者数621名。

2. 調査・研究活動(定款第4条第2号関係)

(1)ワークショップの開催

2002 ワークショップ(修善寺)の開催

9月5日～6日の1泊2日で, ラフォーレ修善寺第一研修館において開催。「21世紀を切り拓く先端実装技術」をメインテーマとし, サブテーマに“製造業復活のカギを握るハイパフォーマンス実装”と題し, 31件の発表(ポスターセッション)と2件の特別講演。参加者数97

名。

関西ワークショップ 2002 の開催

11 月 29 日，京都府中京区，コープ・イン・京都において開催。「実装革命、じわり進行中」をテーマに，20 件の発表(ポスターセッション)と講演 2 件。参加者数 110 名。

(2)低温鉛フリーはんだ実装技術開発プロジェクト成果報告書発行と報告会開催

平成 12 年 8 月から実施されてきた標記プロジェクトの最終成果報告書がまとめられたのを受けて報告会を開催。

成果報告書「低温鉛フリーはんだ実装技術」90 頁

成果報告会 11 月 1 日 全共連ビル 講演 17 件 参加者数 215 名

(3)技術委員会の開催事業

材料技術委員会および 3 研究会合同公開研究会の開催

・ 10 月 15 日、16 日：国立オリンピック記念青少年総合センター

“次世代に向けた実装材料”講演 11 件 参加者数 141 名

電磁特性技術委員会サマーセミナーの開催

・ 8 月 30 日：国立オリンピック記念青少年総合センター

“高速・高周波伝送 / EMC と共振”講演 9 件 参加者数 186 名

信頼性解析技術委員会シンポジウムの開催

・ 9 月 19 日：国立オリンピック記念青少年総合センター

“エレクトロニクス実装における CAE 技術の現状と応用”講演 9 件 参加者数 82 名

装置技術委員会公開研究会の開催

・ 10 月 22 日：回路会館会議室

“これからの微細化新技術(その 2)”講演 5 件 参加者数 100 名

半導体パッケージ技術委員会公開研究会の開催

・ 12 月 13 日：国立オリンピック記念青少年総合センター

“システム実装の将来像”講演 7 件 参加者数 91 名

(4)公開研究会の開催

耐熱性高分子材料研究会

・ 6 月 5 日：東京工業大学百年記念会館

“無機と有機のハイブリッド”講演 4 件 参加者数 70 名

・ 15 年 2 月 19 日：東京工業大学百年記念会館

“ハイスピード化に向けた材料動向”講演 5 件 参加者数 73 名

電磁特性研究会

・ 7 月 18 日：機械振興会館

電子情報通信学会 EMC J と共催，講演 12 件 参加者数 120 名

・ 10 月 17 日：回路会館

システム実装 CAE 研究会と共催，講演 7 件 参加者数 69 名

・ 15 年 2 月 28 日：回路会館

超高速高周波エレクトロニクス実装研究会と共催，講演 8 件 参加者数 60 名

超高速高周波エレクトロニクス実装研究会

・ 5 月 31 日：回路会館

講演 7 件 参加者数 120 名

・ 8 月 23 日：回路会館

講演 6 件 参加者数 60 名

- ・ 11 月 29 日：回路会館
講演 7 件 参加者数 60 名
- ・ 15 年 2 月 28 日：回路会館
電磁特性研究会と共催，講演 8 件 参加者数 60 名
- 最新検査技術討論研究会
 - ・ 12 月 12 日：回路会館
“ 中国のプリント配線板品質保証の実状 ” 講演 1 件 参加者数 15 名
- 先進実装技術研究会・マイクロ接続技術研究会・電子部品研究会合同公開研究会
 - ・ 6 月 4 日：回路会館
講演 5 件 参加者数 63 名
 - ・ 15 年 3 月 7 日：回路会館
講演 5 件 参加者数 48 名
- 光回路実装技術研究会
 - ・ 5 月 21 日：回路会館
講演 4 件 参加者数 58 名
 - ・ 9 月 3 日：回路会館
講演 4 件 参加者数 102 名
 - ・ 11 月 6 日：回路会館
講演 4 件 参加者数 96 名
 - ・ 15 年 1 月 21 日：回路会館
講演 4 件 参加者数 95 名
- 電子機器エコデザイン研究会
 - ・ 12 月 18 日：東京大学先端科学技術研究センター
講演 4 件 参加者数 50 名
- システム実装 C A E 研究会
 - ・ 6 月 28 日：回路会館
“ 今後の設計環境に対する要求・問題点・解決案 ” 講演 5 件 参加者数 42 名
 - ・ 10 月 17 日：回路会館
“ 電磁特性を考慮した高密度実装設計の現状と課題 ” 講演 7 件 参加者数 69 名
- マイクロファブリケーション研究会
 - ・ 5 月 24 日第 7 回公開研究会：回路会館
“ 部品内蔵基板のマイクロファブリケーション ”
講演 5 件 参加者数 123 名
 - ・ 9 月 10 日第 8 回公開研究会：回路会館
“ 部品内蔵配線板のマイクロファブリケーション ”
講演 5 件 参加者数 119 名
 - ・ 12 月 20 日第 9 回公開研究会：回路会館
“ 多層フレキシブル配線板の動向とマイクロファブリケーション ”
講演 6 件 参加者数 129 名
- ビルドアップ配線板研究会
 - ・ 11 月 19 日：回路会館
“ ベアチップ実装における無電解ニッケル金めっき技術の展望 ”
講演 9 件 参加者数 96 名

- ・15年2月14日：回路会館
“ビルドアップ配線板の電気特性の課題と展望”
講演8件 参加者数 86名
- 回路基板ロードマップ研究会
 - ・15年2月6日：回路会館
“プリント配線板ロードマップの最新情報”
講演4件 参加者数 72名
 - ・15年3月19日：回路会館
“プリント配線板ロードマップの最新情報”
講演4件 参加者数 98名
- 加速寿命試験法検討研究会
 - ・12月6日：回路会館
“HASTによる加速劣化試験結果とその課題”
講演12件 参加者数 110名
- MEMS実装研究会
 - ・10月1日：姫路工業大学高度産業科学技術研究所
講演2件 参加者数 30名
 - ・15年3月3日：産業技術総合研究所つくば東事業所
微細部品成形・実装技術研究会と共催，講演3件 参加者数 35名
- 微細部品成形・実装技術研究会
 - ・6月27日：産業技術総合研究所つくば東事業所
講演1件 参加者数 20名
 - ・8月14日：産業技術総合研究所つくば東事業所
講演1件 参加者数 20名
 - ・11月12日，13日：つくば国際会議場
“Power MEMS 2002”
講演70件 参加者数 200名
 - ・11月19日：つくば国際会議場
講演3件 参加者数 25名
 - ・6月27日：産業技術総合研究所つくば東事業所
MEMS実装研究会と共催，講演3件 参加者数 35名
- インキュベーション研究会
 - ・15年3月25日：タイム24ビル
“知的財産ならびに産学連携への取り組み”
講演4件，参加者数 36名

3. 普及・啓発活動(定款第4条第3号関係)

(1)教育講座「実装技術入門講座」

5月16日～17日 学会地下会議室 受講者数41名

(2)PWB製造技術講座

・入門コース

6月20日～21日 国立オリンピック記念青少年総合センター 受講者数37名

・中級コース

- 7月18日～19日 国立オリンピック記念青少年総合センター 受講者数45名
 (3)実装技術総合講座
 10月24日～25日 国立オリンピック記念青少年総合センター 受講者27名
 (4)技能検定設計実技講習会
 11月21日～22日(1泊2日) 国立オリンピック記念青少年総合センター 受講者16名

4. 情報収集及び提供活動(定款第4条第4号関係)

- (1)「エレクトロニクス実装学会誌」の発行
 Vol.5-No.3～7, Vol.6-No.1～2の計7冊を発行。内, Vol.5-No.5は臨時増刊。総頁数716頁。
 (2)海外関係団体出版物の頒布を行い, 海外の技術情報を提供
 ・IMAPS 2002 論文集

5. 内外機関等との交流・協力活動(定款第4条第5号関係)

- (1) International Meeting の開催
 4月18日(ICEP開催2日目), 海外から参加の各国代表者と情報交換を行う。
 (2)ISMP(International Symposium on Microelectronics and Packaging) 2002 の開催
 9月10日, IMAPS Korea および SETEC (韓国半導体装置センター) と共催でソウル・Seoul COEX Convention Center において開催。講演16件(日本5件, 韓国8件, 台湾3件), 参加者数150名。
 (3)エコデザイン 2002 ジャパンシンポジウム開催に協力
 12月5日～6日, 日本科学未来館において開催された, エコデザイン学会連合主催の標記シンポジウムの実施・運営に協力。
 (4)2002JPCA ショー開催を後援
 6月5日～7日, 東京ビッグサイトにおいて開催の2002JPCA ショーを後援した。
 (5)電子SI 連絡協議会に協力
 (6)関連学協会の各種事業に協賛

【協賛】

- 1.電子情報技術産業協会
 「JISSO/PROTEC フォーラムジャパン 2002」11月18日～20日 世界貿易センタービル
2. 日本時計学会
 「2002年秋季マイクロメカトロニクス学術講演会」9月27日 新丸ビル
3. 日本時計学会
 「2003年春季マイクロメカトロニクス学術講演会」15年3月11日 学士会館分館
- 4.電子情報通信学会
 「第6回システムLSI琵琶湖ワークショップ」11月25日～26日 ラフォーレ琵琶湖
- 5.電気化学会
 「半導体集積回路技術シンポジウム」12月12日～13日 機械振興会館
- 6.日本金属学会
 「セミナー 循環型社会における環境・リサイクル技術」12月2日 日本私立学校振興・共済事業団
 「分科会シンポジウム 接合・溶接技術の最前線」12月10日 東京大学先端研
- 7.長野県工科短大公開技術講演会

- 「最新の高性能多層基板技術」7月24日 上田東急イン
8. アジア南太平洋設計自動化会議 2003
- 「ASP-DAC 2003」15年1月21日～24日 北九州国際会議場